Micro Cut M2.02

Antihologramová leštěnka s vysokým leskem, bezsilikonového oleje

Micro Cut M2.02 je mikroleštící přípravek pro strojní leštění nejnovější generace pro trvalé odstranění lešticích závojů, hologramů, jemných škrábanců a broušení od zrnitosti 4 000 na všech lakovaných systémech (včetně odolných proti poškrábání). Použitím vysoce specializovaných, extrémně homogenních brusných tělísek vzniká brilantní a trvanlivý vysoce lesklý povrch i na tmavých a podobně citlivých barevných odstínech za extrémních světelných podmínek. Hologramy a jemné škrábance jsou mechanicky odstraněny. Micro Cut M2.02 je maximálně vydatný, snadno se rozleští a lze jej odstranit beze zbytku. Stupeň broušení: 2,5 Stupeň leštění: 9,0

Oblasti použití

Laky na osobních automobilech, užitkových vozidlech, motocyklech atd.

Doporučené použití

Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme zpracování pomocí naší podušky Micro Cut Pad a vysoce výkonného excentrického lešticího stroje (zdvih min. 15 mm) nebo pomocí excentrického lešticího stroje s nucenou rotací. Pro optimální dávkování naneste rovnoměrně po celé ploše podušky. Leštěnku rovnoměrně naneste na povrch při nejnižších otáčkách stroje a poté leštěte středním tlakem pohybem do kříže, dokud se nevytvoří průhledný film, tedy dokud se obsažený oxid hlinitý zcela nerozloží. Houby používané pro tento výrobek nepoužívejte střídavě pro jiné výrobky. Pro odstranění zbytků leštěnky bez poškrábání doporučujeme naši ultrazvukem řezanou utěrku Polish & Sealing Towel.

Obaly

Obaly	Č. produktu
1 L	468001
0,25 L	468250

Výstražná upozornění

Před použití protřepejte. Před použitím přípravek vyzkoušejte z hlediska vhodnosti a kompatibility. Nepoužívejte na horké povrchy. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami. Nepoužívejte na nelakované plasty a pryž.

Upozornění

Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany.Prověřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozic.